

2021.08.27 新产品发布

提高半导体贴装封装良品率之等离子激光修补设备 (专利申请中待决) 开始销售的通知

艾美柯技术株式会社 (AIMECHATEC, Ltd., 总部: 日本茨城县龙崎市向阳台, 社长: 阿部猪佐雄) 现发布, 作为半导体相关事业的新提案, 新产品-等离子激光修补设备 ALR-04G-P4 现在开始销售。

本设备是为了提高半导体贴装封装制程的良品率而研制开发的。其优势是在焊锡球搭载后、对回流焊和清洗助焊剂的制程中发生的焊锡球脱落不良现象进行检查和修补。主要原理是在发生脱落的位置上补充新的焊锡球, 用等离子和激光进行局部回流焊加以修补。

焊锡球的脱落不良, 是半导体贴装封装制程里良品率降低的主要原因之一。利用本设备的修补功能则可大幅度提高良品率, 增加产能。

现在5G通讯、大数据(Big Data)、物联网(IoT)、人工智能(AI)等的普及在逐渐加速, 所利用的数据中心、移动终端以及车载终端等的半导体封装的需求量也在扩大, 为了对应这些需求需要有稳定的品质和更高的良品率。其中FCBGA、MCU/MPU、2.5/3D、扇出(fanout)等为代表的先进半导体封装制程其需求更为显著, 所以能实现更高良品率的本设备将成为最佳选择。

敝公司愿意通过制程工艺上的不断创新, 为了创造更舒适方便, 更丰富多彩的生活方式, 为社会做出更多的贡献而努力。

咨询: 艾美柯技术株式会社

营业部 TEL: 0297-62-9119

https://www.ai-mech.com/wp_zh/newproducts/



等离子激光修补设备(外观)